金融市場投資週報

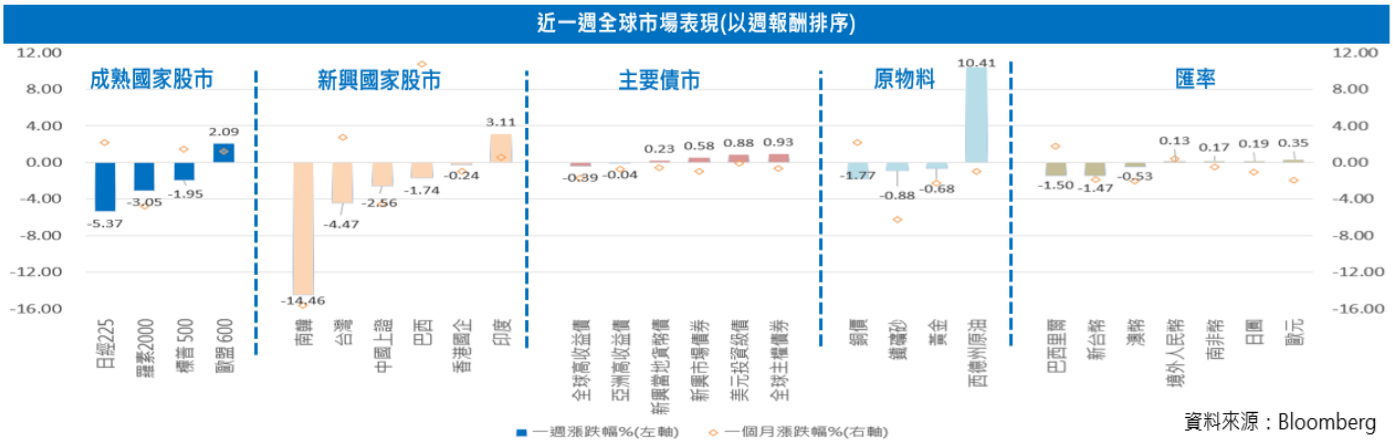
2026 年 10 月 19 日

上週重點訊息

- **美國 9 月通膨升溫，Fed 年底前再升息機率仍高：** 美國 9 月 CPI 年增 3.7%，高於 8 月的 3.4%；核心 CPI 年增率亦由 2.4%升至 2.6%，顯示通膨壓力不只來自能源，核心價格亦有回升。隔日的 PPI 年增率則由 5.6%升至 6.3%，反映上游成本壓力仍強。通膨重新升溫，使 Fed 即使面對就業降溫，也難以快速轉向寬鬆，市場對年底前再度升息的預期仍高。
- **台積電財報創新高，AI 需求強勁但市場轉向檢視融資風險：**台積電 10/15 公布其第三季淨利達 7,631 億元、年增 69%，連續第六季刷新紀錄，第三季美元營收 467.2 億美元，並預估第四季營收將升至 523～543 億美元；公司同時將 2026 全年營收成長預估提高至約 44%，反映 AI 晶片與先進製程需求仍極為強勁。然而，高利率環境使市場開始檢視 AI 資料中心業者的槓桿與融資能力，CoreWeave 約 500 億美元債務引發信用疑慮，引發市場波動。
- **中東衝突再度推高能源風險，油價高檔加劇全球通膨壓力：**胡塞武裝上週攻擊沙烏地阿美設施，伊朗亦表示採取新的海上攻擊策略，使荷莫茲海峽與波斯灣航運風險再度升高。10/16 布蘭特原油與西德洲原油期貨雙雙收在近三週高點。

市場展望

- **科技股中期趨勢料將不變，但短線波動勢將加劇：**近期市場同時面臨通膨升溫、AI 資本支出疑慮與重要科技財報公佈在即等不確定因素，短線風險偏好可能受到壓抑。在利率維持高檔及市場評價偏高的環境下，市場短線料將隨財報結果與市場預期而出現較大波動。然而，上週台積電與 ASML 財報結果整體優於預期，可見 AI 相關企業營運與資本支出尚未出現全面轉弱跡象，科技產業基本面仍具一定支撐，惟後續宜更加重視企業獲利、現金流及資本支出變動及科技子產業的表現分化現象。
- **中天期美債與投資級債債券兼顧息收與利率風險：**美國經濟仍具韌性，加上政府與企業發債供給維持高檔，可能使市場利率持續處於較高水準。雖然投資級債信用利差位於相對低檔，但企業獲利、現金流及償債能力仍具支撐，加上較高的美國公債基準利率，使投資級債的利息收益仍具吸引力。相較之下，短天期債券面臨未來利率下降後的再投資風險，長天期債券則較容易受到公債供給增加、期限溢酬及利率波動影響，因此中天期美國公債與投資債券較能兼顧息收與利率風險。



資料來源：Bloomberg

本報告係無償提供，僅供參考之用。本行當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信之可靠來源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本行及本行之任何董事或受僱人，毋須負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，應審慎衡量本身之需求及投資風險，自行承擔一切投資風險並自負盈虧，本行不負任何法律責任。本報告受中華民國著作權法保護為元大銀行所有，非經本行同意，不得將本報告內容之一部或全部加以複製、轉載或散布。本報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。